인라인 PCB 컨포멀 코팅 영역 및 두께 검사

윤형조*, 이준재* *계명대학교 컴퓨터공학과 e-mail: wlvkcmsh@naver.com

In-Line PCB Coating Area and Thickness Inspection

Hyeong-Jo Yoon*, Joon-Jae Lee*
*Dept. of Computer Engineering, Keimyung Univ.

요 약

PCB의 다양한 원인으로부터의 불량을 막기 위해 PCB에 컨포멀 코팅을 한다. 그러나 컨포멀 코팅의 두께나 영역이 도포 기준에 부합하지 못할 경우 불량이 발생되므로 이에, 두께 및 영역을 검사하는 실시간 측정 장비를 제안한다.

1. 서론

PCB의 부품에 먼지나 불순물이 들어가면 불량품이 된다. 이를 방지하기 위해 PCB의 표면에 컨포멀 코팅을 하여 PCB의 부품을 불순물로부터 보호한다. 이 때 코팅이너무 두껍게 되거나, 원하는 부분 이상으로 코팅이 되거나필요한 부분을 코팅하지 못할 시 불량이 된다. 이를 검사하기 위해 영상처리 기법을 이용해 PCB 코팅의 불량 여부를 판별하는 검사 방법을 연구하고 이를 실제 공장의밸브에서 실시간으로 사용할 수 있는 장비를 만드는 연구이다. 본 연구는 본 연구진의 이전 연구에서 제시한 PCB의 컨포멀 코팅의 두께를 측정하여 정상과 불량을 분별하는 장치에서, 코팅의 영역도 검사하여 코팅의 영역이 일정범위를 초과하는지 못 미치는지를 구분해 불량과 정상을분별하는 장비와 알고리즘을 추가 및 제시 하였다[1-5].

2. 연구배경

PCB의 표면에 센서나 칩 등을 부착할 때 먼지나 불순물이 붙거나 습도 때문에 변형이 되는 것을 방지하기 위해 PCB 표면 위에 컨포멀 코팅을 진행한다. PCB의 불량을 방지하기 위해 코팅을 시도할 때, 너무 두꺼워 PCB 위의 부품이 제 기능을 못하거나 코팅 필요 이상으로 도포되거나 원하는 부분보다 적게 도포되거나 특정 부분을 도포하지 못하는 경우가 되면 오히려 이 때문에 불량이 될수 있다. 이를 방지하거나 특정 부분이 도포되지 않은 경우에는 다시 PCB를 코팅하는 공정으로 이동하여 다시 코팅을 진행해 불량이 생길 수 있는 확률을 줄이 위해 PCB의 코팅 영역을 확인하고 실제 코팅을 하려고 했던 영역과 비교하여 코팅의 영역을 검사할 필요가 있다[1-5].

3. 시스템 구성

본 연구에서 두께 측정 관련 장비와 영역 검사 장비로 구성된다. 두께 측정 장비의 경우 선형 레이저빔과 카메라

(영상광학계)로 이루어져있다. 영역 검사 장비의 경우는 UV 램프와 카메라로 구성된다. 이 때 사용된 카메라는 모두 basler제품의 카메라다[5].

두께 측정의 경우 레이저 기반의 광삼각 방식을 이용해두께를 측정한다. 이를 위해서는 샤임플러그(Scheimpflug)조건인 광학 정렬 상태로 레이저와 카메라가 구성된다[5]. 영역 검사 카메라와 PCB와의 높이를 38.5cm로 설정해서카메라의 해상도를 1280x1024이다. 또한 UV의 설치 높이는 35cm이다. 이는 상황에 맞게 조절할 수 있다.

두께 측정 카메라의 경우는 레이저가 들어오는 부분 일부만을 처리하기 때문에 해상도는 480x240이다. 카메라와 PCB 사이의 거리는 80mm, 카메라의 배율은 1.12, 카메라와 레이저빔이 기울려진 각도는 4도이다. 표 1은 상세 스펙을 기술하였다[5].

표 1. 영역 및 두께 측정 센서 사양

구분	표준사 용거리	측정범위	해상도	속도
영역	385mm	350x280mm	0.28mm	0.03초
두께	80mm	60~500um	5um	0.03초/pt

실제 공장에서의 공정은 먼저 코팅된 PCB가 먼저 영역 검사를 담당하는 밸브로 이동 후 영역 검사를 진행하고 두께 측정하는 밸브로 이동한다. 만약 영역 검사에서 불량 품으로 처리되면 그 PCB는 불량품으로 처리되고, 정상으로 처리되면 다음 검사인 두께측정 밸브로 이동한다.

4. 영역 검사

영역 검사를 하기 위해 UV 램프를 이용한다. 이를 이용하는 이유는 UV 램프를 사용하지 않으면 카메라에 코팅이 보이지 않기 때문이다. UV 램프를 빛이 차단된 공간에서 켜면 코팅면에서만 UV가 반사되어 영상처리를 할수 있는 조건이 된다.

2019년도 한국멀티미디어학회 춘계학술발표대회 논문집 제22권 1호

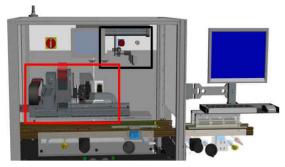


그림 1. 검사 설비 내의 두께(빨강) 및 영역 검사(검정)

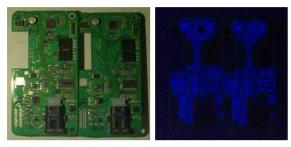


그림 2. UV를 껐을 때(좌)와 켰을 때(우)

사용한 영상처리 기법은 otsu 알고리즘을 이용한 threshold 이진화 영상처리와 이진화된 영상을 각 영역별로 레이블링 하여 나누는 방법으로 연구를 진행하였다.

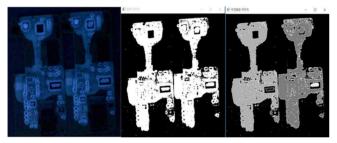


그림 3. 실제 이미지(왼)와 이진화 이미지(중), 영역 설정된 이미지(우)

본 연구에서는 basler 카메라로 입력된 이미지를 캡처한 후 그 이미지를 흑백 이미지로 변환 후 otsu 알고리즘을 이용하여 캡처한 이미지를 이진화한다. 이진화된 이미지를 영역을 나누는 알고리즘을 이용해 각각의 영역을 나누고 그 영역을 또 라벨링 알고리즘을 이용해 라벨링을 한다. 영역을 나누고 라벨링이 된 이미지를 코팅을 할 때특정 영역을 코팅하라고 설정된 마스터 이미지와 코팅된 영역을 비교하여 코팅된 PCB가 불량인지 아닌지를 판단한다. 마스터 이미지와 비교하는 알고리즘은 아직 좀 더연구가 필요하다.

5. 두께 측정

두께 측정은 흑백 카메라로 PCB의 코팅면에서 반사된 두 개의 레이저를 읽어서 신호처리를 통해 두께를 측정한다. 입력된 이미지를 수직으로 누적하여 가우시안 그래프

를 구하고, 구한 가우시안 그래프의 두 정점의 최고점은 주변의 환경에 영향을 받아서 오차가 발생할 수 있어 오차를 줄이기 위해 무게중심을 구한 후 두 무게중심 사이의 거리를 픽셀로 구한다. 구한 거리에 본 연구에서 사용된 PCB의 코팅의 재질에 맞는 캘리브레이션 값인 0.0084를 곱해 실제 PCB 코팅의 두께를 측정한다.



그림 4. 개발한 두께 측정 프로그램 UI

6. 결론 및 연구 방향

두께 측정의 경우 시판되고 있는 시편 필름 50 μm, 103 μm, 124 μm, 290 μm, 430μm을 가지고 실험을 진행했다. 각 시편들마다 8번씩 실험을 진행했고 모두 결과가 ±5μm 이내로 잘 측정되었다. 또한 측정 시간도 0.003초 이내로 측정되었다. 이를 통해 두께 측정 장비는 실제 PCB 생상 공정에 유용할 것으로 기대된다. 영역 검사의경우는 아직 실제 코팅된 영역과 마스터 이미지의 비교알고리즘이 개발 덜 된 상황이라 더 많은 연구가 필요하다. 영역 검사 부분만 더 연구가 된다면 기존의 두께 측정장비나 영역 검사 장비들이 고가의 장비인 것에 비해 이연구에서 사용되는 장비들은 기존의 장비들에 비해 저렴하므로 실제 PCB 공장에서 저렴한 가격으로 PCB의 코팅불량 검사를 진행할 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

- [1] 이준재, 심재창, 정광민, 권기룡, 황석용, "CCD를 이용한 거리측정 레이저 센서 개발," 한국자동어학술대회 논문집, 제3권, pp. 302-304, 1999년 10월.
- [2] 백성훈, 박승규, "광삼각법을 이용한 형상 측정 장치," 한국정밀공학회지, 제22권 4호 pp. 13-18, 2005년 4월.
- [3] 이상준, 이준재, "PCB 솔더 페이스트의 3차원 인라인 검사," 한국멀티미디어학회 추계 학술대회 논문집 pp. 492-495, 2004년 11월.
- [4] 이준재, 이병국, 류재칠, "B-spline 표면 근사화 기반의 3차원 솔더 페이스트 검사", KSIAM IT Series, 제 10권, 1호, pp. 31-45, 2006년.
- [5] 윤형조, 강수명, 이준재, "레이저 광삼각 방법 기반의 PCB 코팅 두께 측정," *제어로봇시스템하회 논문지,* Vol. 25, No. 3, pp. 212-221, 2019